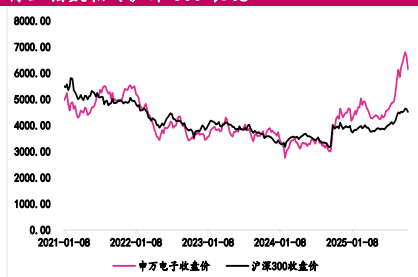


电子行业

2025 年 10 月 19 日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
雅创电子	52.29	24.47	76.69
艾比森	20.10	23.35	74.19
京泉华	24.38	18.81	66.05
睿能科技	19.98	15.49	41.47
*ST 宇顺	37.74	12.12	105.77
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
思泉新材	192.80	-21.90	155.69
华海诚科	101.35	-19.56	81.79
先锋精科	65.30	-19.30	132.15
统联精密	46.98	-18.90	75.82
电连技术	48.18	-18.16	204.68

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20250822 DeepSeek 迎来第二次“杰文斯效应”，应用侧或加速落地

【金元电子】周报 20250907 光通信产业链趋势未改，Scale-up/Scale-out/Scale-across、OCS 助力互连性能提升

【金元电子】周报 20250914 英伟达推出 Rubin CPX 加速推理性能，铜连接、光连接、功率需求高增

【金元电子】周报 20250921HBM 高需求或抢占平面 DRAM 产能，供需错配致使存储涨价

【金元电子】周报 20250928 云栖大会看点多，硬件+平台开放助力国产 AI 芯片及模型落地

【金元电子】碳化硅赋能 AI 产业：从芯片封装到数据中心的核心材料变革

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangr.j@jyzq.cn

行业周度点评报告

—英伟达发布 800V DC 白皮书，“功率墙”应予以重视

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数下跌1.47%，深证成指下跌4.99%，沪深300指数下跌2.22%，申万电子板块下跌7.14%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为31/31。板块个股涨幅前五名分别为：雅创电子、艾比森、京泉华、睿能科技、*ST宇顺；跌幅前五名分别为：思泉新材、华海诚科、先锋精科、统联精密、电连技术。
- **电子行业：**本周电子行业整体呈现普遍下跌的格局，各细分领域表现差异显著。从申万二级行业数据来看，所有板块均出现不同程度的周跌幅。其中，消费电子板块以-9.10%的周跌幅领跑，其细分申万三级行业中，品牌消费电子子板块跌幅最大，达到-9.24%，对板块整体表现造成显著影响。电子化学品板块整体下跌-8.37%，电子化学品III子板块同样下跌-8.37%，表现较为一致。光学光电子板块整体下跌-6.23%，光学元件子板块跌幅为-9.33%，成为板块内表现最弱的细分领域。半导体板块整体下跌-6.53%，半导体设备子板块跌幅为-9.52%，对板块整体表现形成拖累。元件板块整体下跌-7.05%，印制电路板子板块跌幅为-8.22%，表现不佳。其他电子板块整体下跌-6.31%，表现相对平稳。总体来看，电子行业本周各板块及细分领域普遍下跌，跌幅差异较为明显，消费电子板块跌幅最大，其他电子板块跌幅相对较小，行业整体表现较为疲软。
- **行业要闻**
 - ◆ 因AI需求助推，台积电 Q3 财报预计强劲
 - ◆ 微软据报将把 Surface 生产线逐步迁出中国
 - ◆ L&T 半导体与富士康子公司签订高压晶圆协议
 - ◆ NVIDIA DGX Spark 搭载与联发科共同设计 GB10 晶片，10/15 上市
 - ◆ 3. Imec启动300mm GaN项目，专注低压/高压功率电子器件
- **公司动态：**
 - ◆ 希荻微：2024年股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告
 - ◆ 光峰科技：关于与深圳技术大学签署共建联合实验室合作协议暨关联交易的公告
 - ◆ 金安国纪：关于独立董事减持股份实施情况公告
 - ◆ 鸿利智汇：2025年半年度权益分派实施公告
 - ◆ 顺申科技：合肥顺申科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告
- **投资建议：**我们认为，英伟达发布 800V DC架构白皮书明确了当前数据中心功率难题，即所谓“功率墙”。随着单机柜功率从几十千瓦提升到数百千瓦乃至更高，AI服务器供电系统的设计面临全新要求，其核心在于四个方面：电能转换效率及损耗、高功率密度和体积限制、固态变压器（SST）与电力系统集成。当前方案中，sidecar作为过渡方案已有多数厂商提出相对产品，sidecar方案通过分解整流阶段来隔离损耗，从而释放机架内更多IT空间，其过渡性在于交流/直流转换仍在每个IT机架进行，导致电力机架内外产生类似损耗。而800V SST方案则是系统级提升转换效率，将转换阶段移至数据中心前端，通过将电压提升至800伏，使配电损耗大幅降低。所谓SST，本质是一种基于宽禁带功率器件的高频电能变换器。通常包含高压AC/DC功率级、高频隔离变压器以及DC/DC变换等环节，可将例如10-35 kV的中压交流电直接转换为数百伏直流输出。Delta在2024年GTC大会展示了其SST样机，利用多只SiC开关级的模块化串联，配合高频隔离变压器，将10-33 kV中压电直接转换为800 V直流，模块化设计便于冗余和扩展以适应不同国家的电网电压。通过SST输出的800 V DC可直接通过母线送至机架，无需传统PDU变压和多重AC/DC转换，极大简化了配电链路。相关公司包括：1、系统方案商：麦格米特、中恒电气等；2、SST厂商：四方股份、金盘科技、特变电工、中国西电、伊戈尔等；3、功能器件厂商：扬杰科技、斯达半导、芯联集成、英诺赛科等
- **风险提示：** 1、AI应用落地不及预期：国内AI渗透率不及预期，导致基础设施投入不及预期；2、技术风险：当前主流技术仍以传统方案为主，sidecar方案仍在导入期，SST方案未来不确定性仍高；3、政策风险：贸易冲突导致出口企业受限，供货难度加大

目 录

一、核心观点3

二、行业跟踪9

三、行业新闻11

四、公司公告16

五、下周重要事件提示21

图表目录

图 1：随着 AI 电力需求持续攀升，转换效率带来的收益持续上行3

图 2：数据中心变电间，直接将中压市电（例如 10-35 kV 交流）经整流转换为 800V 直流.....3

图 3：sidecar 方案架构5

图 4：SST 方案转换效率提升6

图 5：本周各行业板块涨跌幅9

图 6：本周电子版块：子版块涨跌幅10

图 7：电子板块历史走势11

图 8：电子板块历史市盈率11

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名9

表 2：本周电子版块个股跌幅前五名9

表 3：下周重要会议21

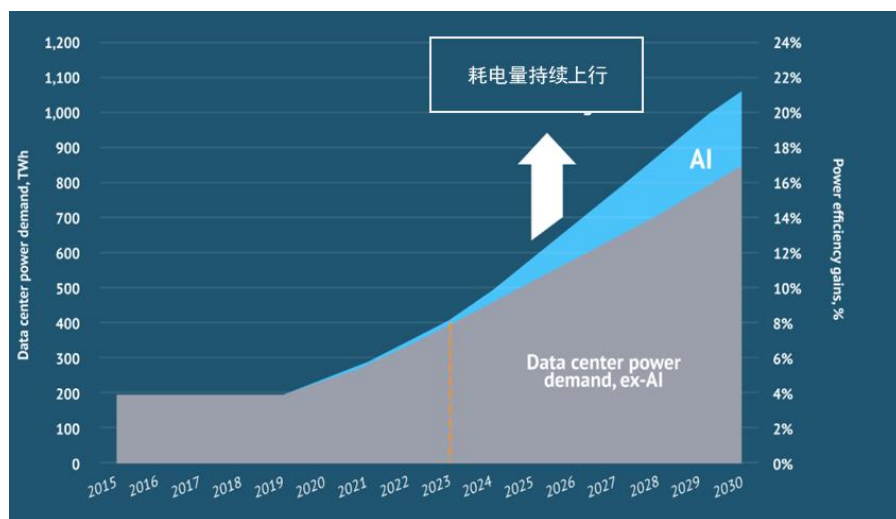
表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）22

一、核心观点

英伟达发布 800V DC 架构白皮书, 提出以 800V 高压直流 (HVDC) 取代现有 54V 机架供电, 以满足 1 MW 级 AI 机架的需求。800V VDC MGX 架构对数据中心供电进行了全方位重新设计, 核心思想是将电源转换从机架内部移出, 改为集中供给高压直流到机架。

我们在深度报告《碳化硅赋能 AI 产业: 从芯片封装到数据中心的材料变革》中指出, 随着单机柜功率从几十千瓦提升到数百千瓦乃至更高, AI 服务器供电系统的设计面临全新要求, 其核心在于四个方面: 电能转换效率及损耗、高功率密度和体积限制、固态变压器 (SST) 与电力系统集成。AI 算力的爆炸式增长正推动数据中心电力需求攀升。传统的机架供电方案 (如 48V/54V 直流母线) 面向千瓦级负载设计, 但面对即将出现的百万瓦 (兆瓦) 级 IT 机架已捉襟见肘。为满足这一趋势, 行业开始重构供电架构, 将供电电压大幅提高至 800 伏直流 (800V DC), 以减少电流、降低损耗并简化供电链路。

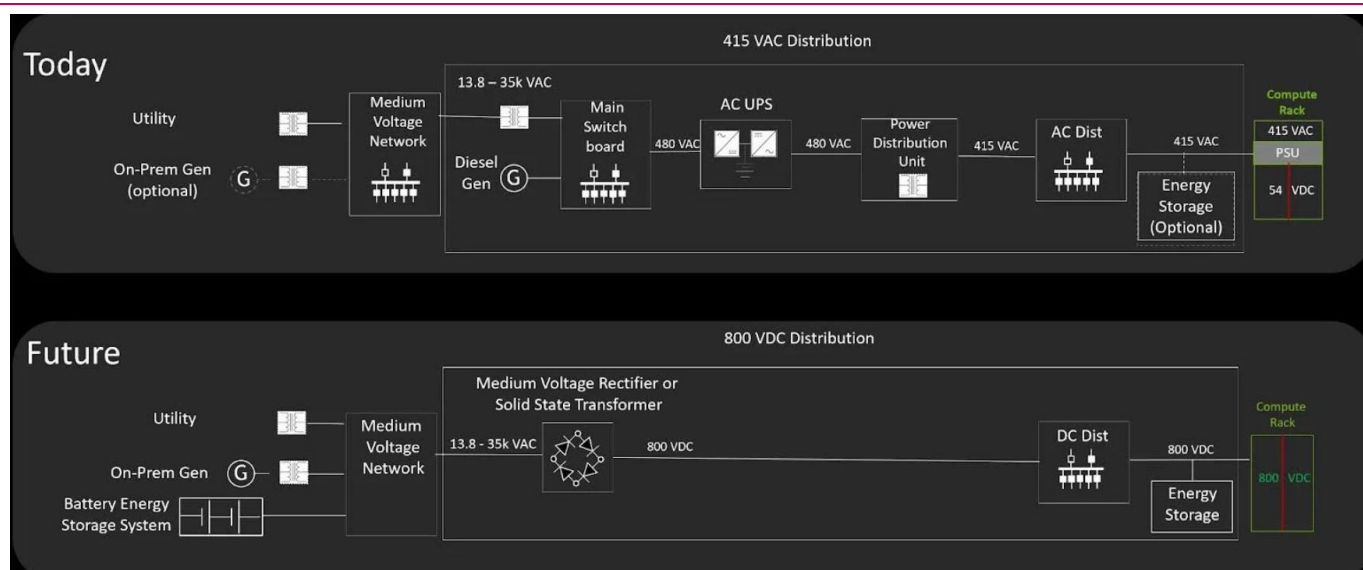
图 1: 随着 AI 电力需求持续攀升, 转换效率带来的收益持续上行



数据来源: Navitas, 金元证券研究所

具体而言, 在数据中心变电间, 直接将中压市电 (例如 10-35 kV 交流) 经整流转换为 800V 直流, 总线上不再经过多级 AC/DC 变换。然后 800V DC 作为母线电压输送至各排机架, 每个 IT 机架直接接受两线制的 800V 直流输入。在机柜侧, 仅需最后一级 DC/DC 转换将 800V 下变为服务器/加速器所需的较低电压 (如 48V、12V, 最终至芯片电压)。这意味着传统散布于机架内的 UPS、电源模块被移出, 机架内部几乎全部用于计算组件。

图 2: 数据中心变电间, 直接将中压市电 (例如 10-35 kV 交流) 经整流转换为 800V 直流



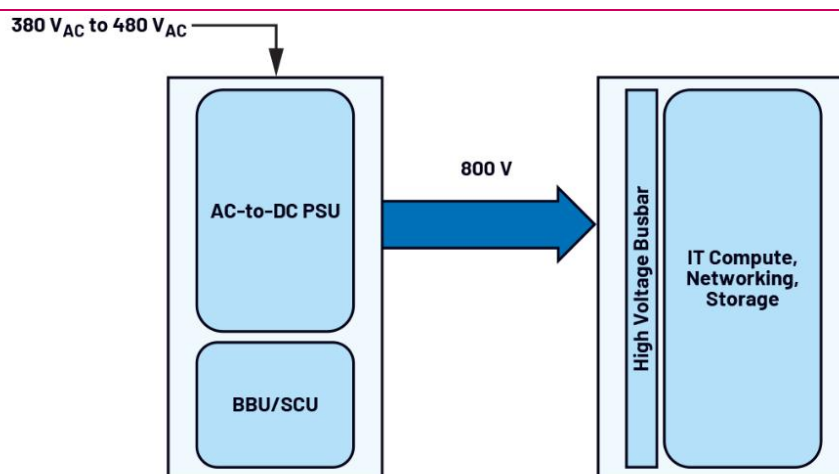
数据来源：英伟达，金元证券研究所

在 800V 直流架构中，一个重要的过渡方案是“Sidecar”侧挂式供电方案。所谓 Sidecar，即将原本与计算设备同机架的供电和备援模块分离出来，放置在计算机架旁的独立机柜中，形似摩托车的边斗挂载，故称“侧挂”式电源柜。这一理念源自 OCP 开放计算等设计，谷歌、Meta 等提出的“Diablo”分离式供电架构也是类似思路：将 PDU、电池、超容等从 IT 机架中拆分到邻接的电力机架，以支持更高电压、更高功率的供电。

Sidecar 的作用是在 800V 架构下充当每个计算机架的专属“供电站”和“缓冲器”。典型的 Sidecar 包含：输入配电单元（从供电室或母线引入 800V DC 或高压 AC）、AC/DC 整流和 DC/DC 变换模块、短时后备储能（电池或超级电容柜）、以及监控保护装置等。以施耐德电气正在与 NVIDIA 开发的 Sidecar 为例，其输入可接驳交流电，经内部整流后提供 800V 直流输出给相邻机架，可为单机架提供高达 1.2 MW 的功率。该 Sidecar 采用模块化电源变换架构，内置模块化电池/电容储能用于短时备援和平抑 GPU 负载波动，并具备“带电热插拔”（Live Swap）能力，支持带电更换模块以提高运维安全性。类似设计的还有伊顿在 2025 年 OCP 峰会上展示的 800V 侧挂电源柜原型，以及台达推出的 EVA 侧挂电源稳压柜，后者通过储能装置限制机架输入电流峰谷差，改善电网冲击。

Sidecar 一般以每个计算机柜配套一个供电柜的方式部署。常见布局是每列机柜中，若干计算机架旁配置一个电源 Sidecar 机架。一些设计甚至在计算机架两侧各放置一个侧挂柜，一个侧挂提供供电/储能，另一个侧挂提供冷却配给，如此组合满足超高功率和高热密度的需求。侧挂柜通常与计算机架通过母线或电缆直接连接，将 800V 直流送入机架内部的末级 DC/DC 模块。在过渡方案中，Sidecar 也可将 800V 下变为 48V 给现有母线，再供设备使用。但长期看，为充分释放机架计算密度，800V 会直接进机柜，省去中间的 48V 级，这需要服务器板卡直接处理高压进线并进行本地降压（这对热插拔控制和安全提出更高要求）。

图 3: sidecar 方案架构



数据来源: Embedded Computing Design, 金元证券研究所

Sidecar 将电源、UPS 电池等迁出 IT 机架，腾出大量 U 空间。NVIDIA 估计采用侧挂式供电，可避免传统 54V 方案中多达 8 个电源架占据机架的一半以上空间，腾出的空间可容纳更多 GPU 板和交换模块，实现更高计算密度。

减少转换损耗，提升效率，侧挂方案通常采用集中高效电源模块。高压在侧挂柜统一整流，再通过单级 DC/DC 给负载供电，避免了机架内多级 AC/DC 反复转换的不必要损耗。台达的 800V 侧挂式 In-Row 电源系统由多只 106 kW 高压电源模块组成，总效率可达 98% 以上，1 个标准机柜即可提供 1.1 MW 的直流输出。

更灵活的维护与扩展。电源柜独立于计算机架，维护时无需干扰计算设备运行。模块化设计支持在线热插拔更换损坏的电源或电池模块。而且根据负载需求可灵活增减 Sidecar 配置，例如双侧挂提高冗余或容量。对于已有数据中心，也可通过部署侧挂柜实现从传统供电向 800V 升级的平滑过渡，一侧连接原有 AC 输入，一侧输出兼容现有 48V 母线，逐步过渡到全 800V 架构。

集成储能和平滑负载：由于 GPU 等负载瞬时波动大，侧挂柜往往预留电池或超级电容用于缓冲峰值。这减少了对上游电网和 UPS 容量的冲击。例如台达的 EVA 侧挂柜利用超容在 GPU 负载尖峰时放电、谷值时充电，将输入电流的峰均比控制在较小范围。这种设计确保在 10 秒短时断电时 Sidecar 亦可支撑机架不中断运行。集成储能还让每机架成为独立电源单元，提高整站可靠性。

但是，sidecar 作为 800V DC 的过渡方案，其缺点在于占用机房空间、配套成本增加、散热与噪音问题、行业标准与兼容性：

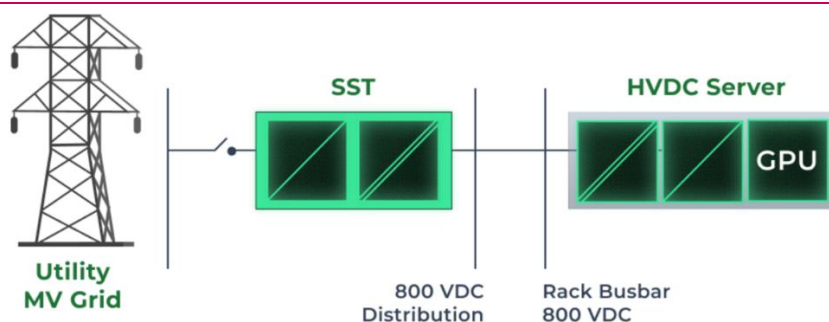
- **占用机房空间：**每个计算机架增加一个配套机柜，无疑需要双倍的地面空间。对于空间紧张的数据中心，这是一大折衷。不过也有方案尝试一对二配置，即一个 Sidecar 夹在两个计算机架中间，为两侧机架供电，从而摊薄空间占用。

- 配套成本增加：侧挂方案需要额外的机柜、母线对接、直流保护装置等，初始投资可能增加。此外，高压直流配电对安全和运维人员培训提出新要求，一旦设计不良可能带来电弧、触电等风险，需要专业方案确保安全（如全封闭母线、防弧光设计等）。对运维来说，同时管理成对的计算和电源机柜也提高了复杂度。
- 散热与噪音问题：侧挂柜内汇聚了高功率整流和 DC/DC 模块，发热和噪声需要妥善处理。一些设计采用液冷为侧挂电源降温，并与计算机架的冷却系统集成。如果没有良好冷却，侧挂柜本身可能成为新的散热热点。
- 行业标准与兼容性：目前 800V HVDC 侧挂供电仍处于研发阶段，各厂商方案差异较大且标准不一。未来需在接口、保护策略等方面形成统一标准，确保不同供应商设备的互通和兼容。这方面 OCP 等组织已经展开工作，ABB 和 Eaton 牵头制定 $\leq 1500V$ 直流配电框架和安全规范

在传统供电体系中，从中压配电网降压并整流得到低压直流，往往需要笨重的工频变压器搭配 AC/DC 整流器。固态变压器(Solid State Transformer, SST)则是一种基于高频功率电子的变压器替代技术，可在电力电子级联中实现高压交流到中低压直流的高效变换。通俗地说，SST 集成了变压、整流和功率调节功能，相当于将变压器+整流器+逆变器融合为一体的电力电子设备。

在 800V DC 数据中心架构中，SST 被寄予厚望，因为它可以直接将中压交流电（10–35 kV）转换为 800V 直流。这意味着传统方案中的中压变压器和低压整流柜可以由一套更紧凑的电子装置取代，从而减少能量转换级数和设备占地。台达电子在 2024 年 GTC 大会上展示模块化 SST 方案即属此例：其设计采用中频变压器来实现隔离和降压，将 10–33 kV 三相交流直接转成 800V 直流，单机柜模块效率高达 98% 以上。ABB 也推出了全球首款固态中压 UPS (HiPerGuard)，本质上也是 SST 架构，将中压交流整流为直流再逆变输出，可为直流供电系统提供不间断电源支持

图 4：SST 方案转换效率提升



数据来源：Trendforce，金元证券研究所

当前 800V DC 方案中，ABB、施耐德电气、维谛、台达等海外厂商均有布局：

- 2025 年 10 月，ABB 宣布与 NVIDIA 合作加速开发 800V 直流供电解决方案，聚焦支撑 1 MW 机架和数 GW 级 AI 园区所需的新型配电技术。ABB 重点的产品与技术包括中压级别的不间断电源(MV UPS)，ABB 的 HiPerGuard 被称为全球首款固态中压 UPS，采用电力电子将中压 AC 直接转换为 DC 并

逆变，效率高达 98% 以上。在 800V 直流架构中，ABB 设想用这类 MV UPS 取代传统低压 UPS，即在中压侧提供不间断支持并直接输出 800V 直流，省却了低压变压器环节。这种方案可大幅缩减电气室面积，同时提高效率和动态响应。ABB 针对 800V 直流研发了定制的开关柜和保护元件。例如其 MNS 低压开关柜家族进行了升级，集成新一代 SACE Emax 3 断路器，可适应 800V 直流高开断要求

- 2025 年 10 月施耐德发布新闻稿强调对 800V DC 的承诺，宣布正与 NVIDIA 密切合作开发支持兆瓦机架的创新供电系统，施耐德的 800V 直流解决方案亮点包括 Sidecar 侧挂式供电柜：施耐德与 NVIDIA 联合开发了一款 800V 侧挂电源柜，定位于每个机架提供最高 1.2 MW 的直流电力。该 Sidecar 将数据中心配电进线的 AC 电源转换为 800V DC 输出。采用模块化架构，由多块高效 AC/DC 电源模块组成，同时集成模块化储能（电池或超容）用于短时备援和平滑负载。值得一提的是，该侧挂柜支持带电热插拔设计，运维人员可在系统带电情况下安全更换电源或储能模块，无需停机
- 早在 2025 年 5 月，Vertiv 便与 NVIDIA 宣布战略合作，共同推动 800V 高压直流标准。2025 年 GTC 大会上，Vertiv 展示了 800V MGX 参考架构，将电力和冷却基础设施结合提供完整解决方案到。2025 年 10 月，Vertiv 宣布其 800V 直流产品平台进入工程验证阶段，计划于 2026 年下半年发布商业化产品线，以配合 NVIDIA Rubin Ultra 平台在 2027 年的部署时间表。Vertiv 的 800V 直流方案强调系统级整体设计和服务能力，集中整流与母线输电，Vertiv 倡导在数据中心电气室设置集中式整流器，将 13.8 kV 等中压交流直接整流为 800V 直流，然后通过高效母线送往白空间的列排。针对 IT 机架需要将 800V 降压，Vertiv 开发了机架级 DC/DC 转换模块。这些模块可安装于机架侧或顶部，将 800V 下变为适合服务器背板或 GPU 板的电压（可能是 48V 或直接 12V）
- 台达开发了模块化固态变压器柜，可将 10-33 kV 交流直接转换为 800V 直流，效率最高约 98.5%。该 SST 柜采用模块化电力电子架构，可通过并联/串联模块适应不同国家的中压等级，同时提供冗余以提高可靠性。此外，台达推出了行级（In-Row）高压直流供电柜，旨在为每排机架提供集中供电。其最新型号为 1 MW 级，内置多达 10 套 106 kW HVDC 电源架（每架含若干 AC/DC 模块），可在一个 19 英寸机柜内输出总计约 1.1 MW 的 800V 直流

我们认为，英伟达发布 800V DC 架构白皮书明确了当前数据中心功率难题，即所谓“功率墙”。随着单机柜功率从几十千瓦提升到数百千瓦乃至更高，AI 服务器供电系统的设计面临全新要求，其核心在于四个方面：电能转换效率及损耗、高功率密度和体积限制、固态变压器（SST）与电力系统集成。当前方案中，sidecar 作为过渡方案已有多数厂商提出相对产品，sidecar 方案通过分解整流阶段来隔离损耗，从而释放机架内更多 IT 空间，其过渡性在于交流/直流转换仍在每个 IT 机架进行，导致电力机架内外产生类似损耗。而 800V SST 方案则是系统级提升转换效率，将转换阶段移至数据中心前端，通过将电压提升至 800 伏，使配电损耗大幅降低。

所谓 SST，本质是一种基于宽禁带功率器件的高频电能变换器。通常包含高压 AC/DC 功率级、高频隔离变压以及 DC/DC 变换等环节，可将例如 10 - 35 kV 的中压交流电直接转换为数百伏直流输出。在 NVIDIA 提出的架构中，SST 设计为独立的模块化柜安装在数据中心供电入口，将 13.8 kV 三相市电直接变换为 800 VDC 母线电压。Delta 在 2024 年 GTC 大会展示了其 SST 样机，利用多只 SiC 开关级的模块化串联，配合高频隔离变压器，将 10 - 33 kV 中压电直接转换为 800 V 直流，模块化设计便于冗余和扩展以适应不同国家的电网电压。通过 SST 输出的 800 VDC 可直接通过母线送至机架，无需传统 PDU 变压和多重 AC/DC 转换，极大简化了配电链路。

相关公司包括：

- 1、系统方案商：麦格米特、中恒电气等
- 2、SST 厂商：四方股份、金盘科技、特变电工、中国西电、伊戈尔等
- 3、功能器件厂商：扬杰科技、斯达半导、芯联集成、英诺赛科等

风险提示：

1、AI 应用落地不及预期：

国内 AI 渗透率不及预期，导致基础设施投入不及预期

2、技术风险：

当前主流技术仍以传统方案为主，sidecar 方案仍在导入期，SST 方案未来不确定性仍高

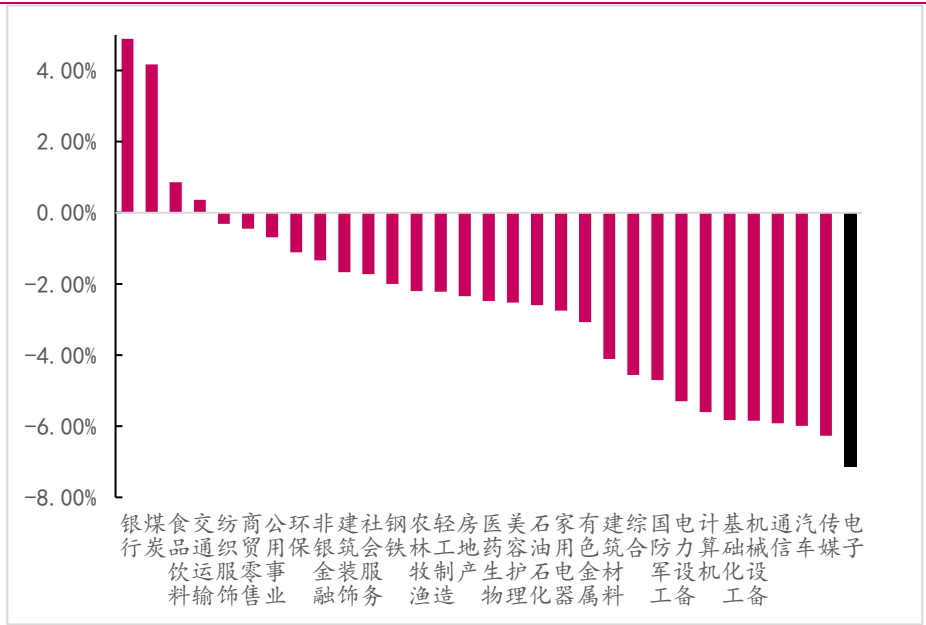
3、政策风险

贸易冲突导致出口企业受限，供货难度加大

二、行业跟踪

全行业：本周（2025. 10. 13-2025. 10. 17）本周上证指数下跌 1.47%，深证成指下跌 4.99%，沪深 300 指数下跌 2.22%，申万电子版块下跌 7.14%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 31/31。板块个股涨幅前五名分别为：雅创电子、艾比森、京泉华、睿能科技、*ST 宇顺；跌幅前五名分别为：思泉新材、华海诚科、先锋精科、统联精密、电连技术。

图 5：本周各行业版块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
301099.SZ	雅创电子	24.47	52.29	38.30	55.60	118.59	106.47	51.73
300389.SZ	艾比森	23.35	20.10	15.31	20.10	25.12	58.58	10.39
002885.SZ	京泉华	18.81	24.38	19.17	26.78	114.11	263.50	61.46
603933.SH	睿能科技	15.49	19.98	16.01	19.98	21.08	43.76	7.90
002289.SZ	ST 宇顺	12.12	37.74	31.98	39.40	7.31	20.46	7.47

数据来源：Choice，金元证券研究所

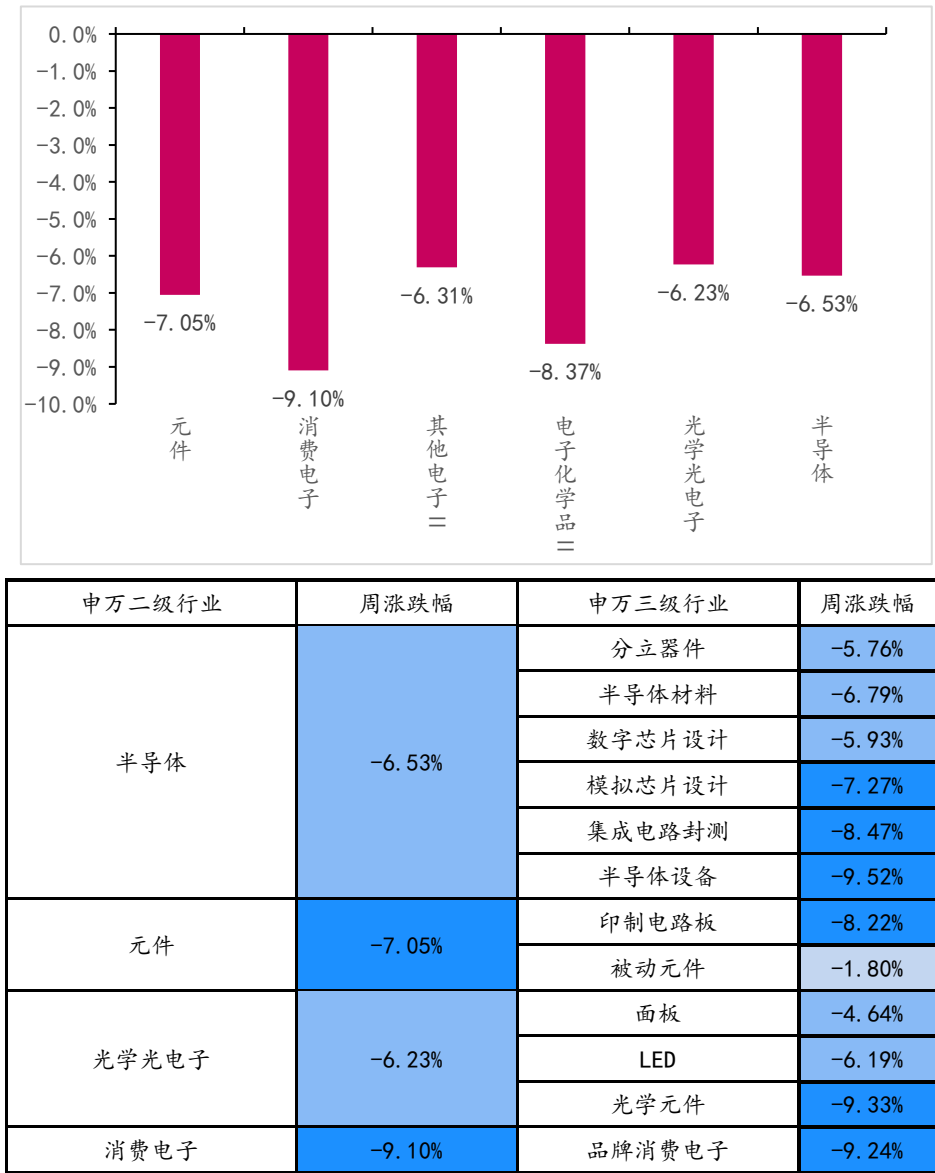
表 2：本周电子版块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
301489.SZ	思泉新材	-21.90	192.80	190.38	265.00	69.05	32.87	72.60
688535.SH	华海诚科	-19.56	101.35	101.00	128.83	52.77	27.68	31.63
688605.SH	先锋精科	-19.30	65.30	64.98	83.70	80.84	32.72	24.38
688210.SH	统联精密	-18.90	46.98	46.21	58.20	24.40	39.38	20.05
300679.SZ	电连技术	-18.16	48.18	48.11	57.47	15.01	53.92	28.17

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025. 10. 13-2025. 10. 17）电子行业本周整体呈现普遍下跌的格局，各细分领域表现差异显著。从申万二级行业数据来看，所有板块均出现不同程度的周跌幅。其中，消费电子板块以-9.10%的周跌幅领跌，其细分申万三级行业中，品牌消费电子子板块跌幅最大，达到-9.24%，对板块整体表现造成显著影响。电子化学品板块整体下跌-8.37%，电子化学品III子板块同样下跌-8.37%，表现较为一致。光学光电子板块整体下跌-6.23%，光学元件子板块跌幅为-9.33%，成为板块内表现最弱的细分领域。半导体板块整体下跌-6.53%，半导体设备子板块跌幅为-9.52%，对板块整体表现形成拖累。元件板块整体下跌-7.05%，印制电路板子板块跌幅为-8.22%，表现不佳。其他电子板块整体下跌-6.31%，表现相对平稳。总体来看，电子行业本周各板块及细分领域普遍下跌，跌幅差异较为明显，消费电子板块跌幅最大，其他电子板块跌幅相对较小，行业整体表现较为疲软。

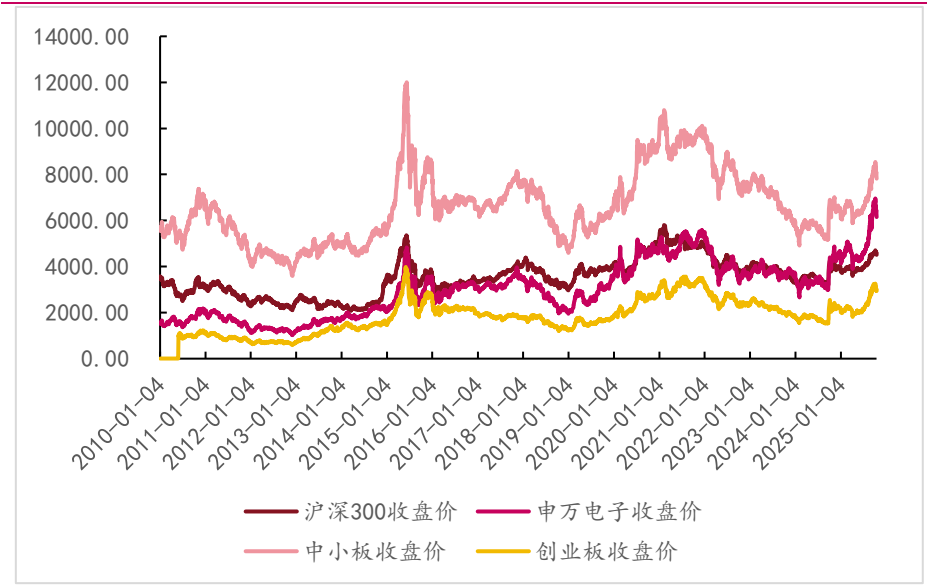
图 6：本周电子版块：子版块涨跌幅



		消费电子零部件及组装	-9.08%
电子化学品	-8.37%	电子化学品Ⅲ	-8.37%
其他电子	-6.31%	其他电子Ⅲ	-6.31%

数据来源：Choice，金元证券研究所

图 7：电子板块历史走势



数据来源：Choice，金元证券研究所

图 8：电子板块历史市盈率



数据来源：Choice，金元证券研究所

三、行业新闻

荷兰将对闻泰科技旗下安世半导体采取限制措施，中国外交部回应

10月14日据中国外交部网站报道，在当日例行记者会上，外交部发言人林剑

就涉及荷兰对闻泰科技旗下安世半导体采取限制措施的相关提问表示，具体情况请向中方主管部门了解；中方一贯反对泛化“国家安全”概念和将经贸问题政治化，有关国家应切实遵守市场原则，中方维护自身正当合法权益的决心坚定不移。此前10月12日闻泰科技公告称，其控股子公司安世半导体因荷兰方面指令，自9月30日起资产与知识产权等调整被冻结一年，且荷兰企业法院对公司治理作出临时处置，公司随后发表严正声明表示坚决反对并将采取一切合法合规手段维护权利。

OpenAI与博通达成“10GW客制化AI芯片”合作，部署自2026年下半年启动

10月14日据路透社报道，OpenAI将与博通合作打造其首批自研AI处理器与机架系统，规划总规模超过10GW的算力平台，预计2026年下半年开始分批部署、到2029年完成滚动落地。双方未披露财务条款，但业内测算“每1GW数据中心投资可达约500-600亿美元”，显示OpenAI对定制化算力与成本控制的长期承诺；系统将采用博通以太网堆叠进行互联，形成对英伟达生态的替代补充。消息公布后，市场解读为AI基建CAPEX周期继续抬升，博通在定制加速器与网络栈的话语权进一步增强。

台积电明年资本支出有望再创高位

10月14日据爱集微报道，台积电将在10月16日法说会上给出最新展望。台媒与供应链消息称，2nm基地已进入试产与验证阶段，整体良率接近七成；年底有望首批量产投片，明年中放大出货。苹果、AMD、高通、联发科等大客户已预订完明年2nm产能，叠加CoWoS/SolC等先进封装全线“塞爆”，机构预计2026年资本开支仍将抬升、有机会高于今年的380-420亿美元再创新高。

南亚科：Q4DRAM价格更好已确定，展望正面、明年仍看多

10月14日据财讯快报报道，南亚科技总经理李培瑛在法说会前受访表示：2024年DRAM市况“两极化”，AI相关产品强劲、非AI产品偏弱；厂商正将DDR4/LPDDR4产能转向HBM/DDR5/LPDDR5，供给趋紧，带动第四季价格优于第三季已成定局，公司毛利与获利有望持续改善。其并判断2026年可能是“很不错的一年”；同时强调产品代际更替下DDR4市场将逐步缩小，公司将依客户需求动态调配产能结构。

联发科携手达发科技发表AI光纤网路闸道器，网路效能提升逾30%

10月14日据NOWnews报道，联发科与子公司达发科技在巴黎NetworkX2025展会首发面向电信运营商的AI光纤网路闸道器（Gateway）平台：宣称通过AI自主学习优化Wi-Fi-PON的任务调度，实现用户体验（QoE）提升30%+、吞吐提升约20%、并将平均修复时间（MTTR）缩短约40%；平台支持prp10S/RDK-B/OpenWRT，计划与Wi-Fi7Filologic680和XGS-PONAN7581深度融合，最高可对接50TOPS级NPU以承载边缘AI服务。

三星Q3利润暴增31.8%，芯片牛市获最强验证

10月14日据路透社报道，韩国半导体巨头三星电子公布其2025年第三季度初步业绩，营业利润高达12.1万亿韩元，同比增长约32%；营业收入同比增长约8.7%，达86万亿韩元。此次业绩大幅增长被归因于AI与数据中心带动的存储

器需求激增，尤其是高性能存储器，如用于AI服务器的HBM，需求迅猛上涨。报告还指出，在DRAM与NAND市场价格回暖的背景下，三星存储器业务成为利润主力，全面超出市场预期。

中国台湾：中国大陆稀土出口管制，对岛内半导体产业影响有限

10月15日据爱集微报道，中国台湾地区经济部门10月12日表示，由于稀土与芯片行业所需的金属不同，预计中国大陆新的稀土限制措施不会对中国台湾半导体行业产生重大影响。10月9日，中国大陆大幅扩大了稀土出口管制范围，新增五种元素，并对芯片客户进行额外审查。中国台湾经济部门在一份声明中表示，扩大禁令涵盖的稀土元素与中国台湾半导体工艺所需的稀土元素不同，因此目前预计不会对芯片制造产生重大影响。该声明补充说，中国台湾所需的稀土产品或衍生物主要来自欧洲、美国和日本。中国台湾是全球最大芯片代工厂台积电的所在地，该公司生产绝大多数先进芯片，而这些芯片是人工智能应用的关键部件。然而，中国台湾部门补充称，中国大陆最新扩大的稀土管控措施可能会影响电动汽车和无人机等产品的全球供应链，并表示需要密切关注其影响。

NVIDIADGXSpark搭载与联发科共同设计GB10晶片，10/15上市

10月15日据科技新报报道，辉达即将上市的NVIDIADGXSpark个人AI超级电脑，搭载联发科与NVIDIA合作设计的GB10GraceBlackwell超级晶片，NVIDIADGXSpark让开发者能在本地端对大型AI模型进行原型设计、微调和推论。DGXSpark将于10月15日上市，预计将驱动各产业迎来新一波的AI发展。联发科指出，GB10GraceBlackwell超级晶片中GraceCPU采用20核心Arm架构，充分展现联发科在高效能、低功耗设计、记忆体子系统及高速介面上的技术实力。结合最新一代BlackwellGPU与128GB统一架构记忆体，GB10提供高达1PFLOPAI算力，以大幅加速模型调校与即时推论。

Imec启动300mmGaN项目，专注低压/高压功率电子器件

10月15日据爱集微报道，imec启动了一项新的开放式创新项目，专注于低压和高压功率电子器件的300mmGaN（氮化镓）技术。该项目旨在提升GaN器件性能，同时降低制造成本，标志着功率半导体行业向前迈出了重要一步。对于功率电子、半导体和代工生态系统领域而言，这一进展凸显了向300mmGaN晶圆加工的关键转变，这将加速GaN在汽车、数据中心和可再生能源应用中的普及。300mmGaN项目是imecGaN功率电子工业联盟计划的一部分，其首批合作伙伴包括AIXTRON、格罗方德、科磊、新思科技和Veeco等主要企业。此次合作将专注于开发与300mm晶圆兼容的GaN外延生长和高电子迁移率晶体管工艺流程。

Google印度打造AI枢纽，美国境外最大五年砸150亿美元

10月15日据科技新报报道，Google今天宣布将在印度东南部安德拉邦建置一座巨大资料中心和人工智慧基地，强调五年内将投资印度150亿美元。法新社报导，GoogleCloud执行长库里安（ThomasKurian）仪式时指出：这是我们在美国以外任何地方所投资的规模最大AI枢纽。库里安宣布五年资本投入达150亿美元，在安德拉邦（AndhraPradesh）维沙哈巴南市（Visakhapatnam）建置GW（Gigawatt，百万瓩）级AI枢纽。

x86以外新选择？传AMD明年推Arm架构APU，疑现踪出货清单

10月15日据科技新报报道，AMD与英特尔才在13日宣布，双方在x86生态咨询小组合作已达成多项技术里程碑。但据外媒WCCFTech报导，有传闻指出AMD正准备推出Arm架构APU，而且疑似已经出现在出货单上。为了抵抗Arm架构攻势，AMD与英特尔合作并成立x86生态咨询小组，至今已合作一年，确保x86架构的竞争力。不过，市场消息传出，AMD的SoundwaveAPU将于明年登场，抢攻新兴WindowsonArm市场。

新凯来子公司发布两款国产EDA设计软件，成“湾芯展”人气王

10月15日据证券时报报道，2025湾区半导体产业生态博览会在深圳开幕，深圳市新凯来技术有限公司展台凭借子公司的重要新品发布，成为展会“人气王”。界面新闻了解到，新凯来子公司启云方首次向业界发布了两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA（原理图和PCB）设计软件。据其介绍，启云方电子工程EDA设计软件在电子电路设计重要指标方面已达业界一流水平，产品性能较行业标杆提升30%，软件支持多人并行协同设计、随时随地在线检视，产品硬件开发周期缩短40%，智能辅助设计一版成功率提升30%。

微软据报将把Surface生产线逐步迁出中国

10月16日据TheVerge报道，微软计划从2026年起将其Surface笔记本、平板及部分服务器硬件的生产从中国迁出。报道称，微软已开始把部分服务器产品投向其他国家制造，并考虑将Xbox与零组件的组装也搬迁。此举被视为在中美贸易与供应链风险加剧背景下，大厂调整制造基地以分散风险的典型案例。

因AI需求助推，台积电Q3财报预计强劲

10月15日据Digitimes报道，台积电已安排于10月16日召开线上财报说明会，市场普遍预期其第三季业绩将超预期。分析师指出，受AI应用扩张推动，对高阶晶圆片的需求上升，加上成本控制得宜，台积电有望维持毛利率与营运弹性。

美国FCC拟取消香港电信运营商在美授权

10月15日据Reuters报道，美国联邦通信委员会（FCC）已发出“showcause”命令，要求香港电信运营商HKTInternational说明为何其在美国的授权不应被撤销。FCC指出出于国家安全考量，该公司的业务可能威胁美国通信基础设施安全，此案在10月底面临投票决定。

中国称若出口管制升级，全球将脱钩电子供应链

10月16日据FT报道，美国方面警告中国若继续推行稀土/关键矿物出口许可制度，可能加速全球产业链“脱钩”趋势。美方官员认为，中国拟对与高阶芯片制造相关的稀土出口实施更严格许可要求，已引起业界对半导体与电子制造供应链安全的担忧。

L&T半导体与富士康子公司签订高电压晶圆协议

10月15日据EconomicTimes报道，印度L&TSemiconductorTechnologies与富士

康旗下HonYoungSemiconductor（鸿洋半导体）达成战略合作，共同开发650V - 3300V高压功率半导体晶圆。此类器件在电动汽车、工业电源等场景需求强劲，协议意在扩展在高压功率电子领域的布局。

中国回应美方“稀土脱钩”言论，称民用出口许可仍开放

10月16日据路透社报道，中国商务部回应美方指责称，稀土出口管理并非全面禁令，民用和科研用途仍可申请许可。美方此前警告中国新规可能加剧全球供应链脱钩。业内认为，此举短期或影响芯片及电动车材料供应，但也将推动本地替代进程。

400亿美元AI大投资，英伟达等财团收购数据中心运营商Aligned

10月17日据路透社报道，英伟达、xAI、微软与贝莱德等公司组成的“AI基础设施合作伙伴关系”，AIP，将以400亿美元收购全球大型数据中心运营商Aligned，此为该财团的首次重大投资。AIP计划部署约300亿美元股权资本，结合债务融资后整体规模可达1000亿美元。交易预计在2026年上半年完成，Aligned总部将继续位于德州达拉斯。Aligned当前在美国及拉美拥有50个数据中心园区，总容量超5GW，财团计划未来几年将规模翻倍以应对激增的算力需求。此举被视为AI基础设施资本扩张浪潮的标志性事件，或将带动全球服务器、GPU及数据中心建设全面提速。

韩媒：三星传加购最新型High-NAEUV，投资金额逾1兆韩圆

10月17日韩国经济新闻报导，三星电子计划在2026年上半年投资约1.1兆韩圆，采购荷兰ASML最新一代High-NAEUV光刻机两台，其中一台预计年底前交付、另一台将于明年上半年导入。该机型EXE:5200B的数值孔径提升至0.55，解析度提升约1.7倍，可大幅提高电路密度与良率。三星将在2025年启动2nm制程量产，并于2027年导入1.4nm节点，High-NAEUV将成为提升制程竞争力的关键。每台设备单价高达5500亿韩圆，业界指出其对资本支出影响巨大，但对三星巩固逻辑芯片领先地位具有战略意义。

加快大容量HDD验证速度，威腾电子启用扩建SIT实验室

10月17日据TechNews科技新报报道，威腾电子宣布在美国明尼苏达州罗彻斯特启用扩建的系统整合与测试实验室，面积达25,600平方英尺，用于验证下一代大容量HDD。该实验室提供迷你数据中心环境，能在实际负载下进行产品测试，以加速研发到量产的周期。威腾指出，随着AI与云计算驱动的数据存储需求爆炸，HDD仍占全球云端数据80%存储量，是AI经济的关键支柱。公司产品长AhmedShihab表示，新的实验室体现WD致力于成为客户“并肩创新”的合作伙伴，以规模化高密度存储技术支撑未来算力需求。

魏哲家：2奈米良率好、本季如期量产，A16/N2P明下半年同步登场

10月17日据TechNews科技新报报道，台积电在第三季度法说会上确认2nm（N2）制程将于本季稍晚量产，良率表现良好。董事长魏哲家表示，公司正按计划推进N2P与A16两个延伸节点，其中N2P将在2026下半年量产，以提升功耗比；A16则采用SuperPowerRail结构，聚焦高功耗HPC应用。CFO黄仁昭指出，N2初期量产将带来短期毛利稀释，但2026年整体毛利预计回到公司平均水平，海

外厂初期仍会带来约2-3%稀释效应。业内认为，台积电已稳步迈入次世代制程节点竞争阶段。

美光计划退出中国数据中心服务器芯片业务

10月17日据路透社报道，美国存储与半导体巨头Micron计划因无法恢复其在中国市场的服务器芯片业务，自中国市场撤出对数据中心的此类芯片供应。消息人士称，自2023年中国对其在关键基础设施领域的禁令以来，Micron在这一业务线一直难以恢复盈利。公司将继续对中国的汽车和手机等终端市场供应芯片。该决定意味着在AI与大规模云算力需求爆发的背景下，中美之间的技术与供应链博弈正在进一步加剧。链接：路透社稿件。

罗博特科：签订单笔金额约7.61亿元光伏电池整线解决方案合同

10月17日据每日经济新闻报道，罗博特科（300757.SZ）公告称，公司已与境内某光伏企业D的控股子公司签订一笔金额约7.61亿元人民币（含税）的光伏电池整线解决方案合同，占公司2024年度经审计营业收入的68.83%。公司表示，该项目的实施将对本年度及未来年度经营业绩产生积极影响，标志其在光伏高端装备制造领域的市场拓展取得重大进展。公告指出，交易对手方资信良好、具备履约能力，合同履行仍可能受到政策或市场环境等不可控因素影响。该合同无需提交董事会及股东大会审议。

四、公司公告

可川科技：关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议的公告

公司10月14日发布公告，苏州可川电子科技有限公司表示，其控股股东及实际控制人朱春华和施惠庆于10月10日续签一致行动协议，以维持公司控制权稳定并提高重大事项决策效率。双方此前于2018年首次签署一致行动协议，并在2020年签署补充协议，约定有效期至公司上市后三年，即2025年10月10日到期。续签后，朱春华持股36.51%，施惠庆持股33.44%，两人合计持股69.95%。新协议约定双方在涉及公司经营发展和重大决策事项时应采取一致行动，如意见不一致，以朱春华意见为准，协议自签署之日起生效，有效期两年。公司表示，本次续签不会导致控制权变化，有助于保持经营决策的稳定性和连贯性。

联动科技：2025年半年度权益分派实施公告

公司10月14日发布公告，佛山市联动科技股份有限公司宣布2025年半年度利润分配方案将以总股本7,057.54万股扣除回购股份62.29万股后的6,995.25万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发约1,049.29万元，不送红股、不转增股本。股权登记日为10月21日，除权除息日为10月22日。公告指出，公司通过回购专用账户持有的股份不参与分红，除权除息参考价按每股减0.1486759元计算。现金红利由中国结算深圳分公司代发，部分股东由公司自行派发。红利税按投资者身份及持股期限差别化征收。公司同时将根据本次分红调整限制性股票授予和回购价格及相关股东的最低减持价限制。

万润股份:关于与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

公司10月14日发布公告，中节能万润股份有限公司拟与控股股东中国节能环保集团旗下全资子公司中节能财务有限公司续签《金融服务协议》，以继续获得存款、结算及信贷等综合金融服务。原协议于2022年签署，期限三年，将于2025年11月到期。新协议有效期三年，约定财务公司在存款利率、贷款利率、服务费用等方面不得劣于商业银行同类业务水平，综合授信额度原则上不超过20亿元，公司存款余额不超过上年度经审计货币资金的60%。公告指出，续签协议系关联交易，已获董事会、监事会及独立董事审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。公司表示，此举有助于优化财务管理、降低融资成本，不会损害中小股东利益或构成重大资产重组。

德明利:关于2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

公司10月14日发布公告，深圳市德明利技术股份有限公司称其2024年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期条件已成就，75名激励对象满足解限要求，将按已获授数量的40%合计解除限售622,160股，占截至2025年9月30日公司总股本的0.27%；本次首次授予登记日为2024年10月13日、上市日为2024年10月14日，首个限售期于2025年10月13日届满，公司2024年度营业收入同比增长168.74%达标，个人绩效亦整体达标，故公司层面与个人层面解限比例均为100%，相关股份将在办理完解除限售手续并于上市流通前另行提示，不涉及控制权变更。

苏州天脉:关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

公司10月14日发布公告，苏州天脉导热科技股份有限公司披露其《2025年限制性股票激励计划》已满足授予条件并于10月13日首次授予，向符合条件的56名董事、高管、中层及核心骨干授予108.10万股第二类限制性股票，授予价为每股65元，标的来源为公司定向发行；本计划总规模不超过128万股，其中预留19.90万股，计划有效期最长不超过60个月，首次授予部分按“授予满12/24/36个月”分三个归属期以40%、30%、30%比例分次归属，归属需同时通过公司层面业绩考核和个人绩效考核；公司称已完成公示、自查并获得股东大会及董事会相关授权与审议通过，律师出具合规意见；按会计准则测算，首次授予对应股份支付费用合计约6106.58万元，将在2025—2028年分期计入费用，预计不影响公司控制权且有助于稳定与激励核心人才。

盈方微:关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

公司10月15日发布公告，于2025年9月24日召开了第十二届董事会第二十八次会议和第十二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。2023年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第二个行权期行权条件已满足，目前公司47名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为731.50万份，

行权价格为6.32元/份。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关手续的办理。

炬光科技:西安炬光科技股份有限公司关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告

公司10月15日发布公告，于2025年10月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，公司2024年资产收购相关限制性股票激励计划。首次授予的第一个归属期归属条件已成就，共计430名符合条件的激励对象合计可归属第二类限制性股票1,040,616股。

圣邦股份:关于2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

公司10月15日发布公告，于2025年8月28日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2023年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期可行权的公告》

颀中科技:合肥颀中科技股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

公司10月15日发布公告，持有深圳市金百泽电子科技股份有限公司股份112,500股的副总经理潘权先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过28,100股。持有公司股份56,250股的副总经理陈春先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过14,000股。

金百泽:关于高级管理人员减持股份的预披露公告

公司10月15日发布公告，根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。截至2025年10月15日，以公司总股本1,189,037,288股，扣除公司回购专用证券账户中股份数8,714,483股后的股本数1,180,322,805股为计算基数，预计分配现金红利59,016,140.25元（含税）。

汇创达:关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告

公司10月15日发布公告，持有公司股份29,499,130股的股东宁波通慕创业投资合伙企业计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即从2025年11月6日起至2026年2月5日以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过5,189,100股，其中以集中竞价方式减持持有的公司股份不超过1,729,700股；以大宗交易方式减持公司股票不超过3,459,400股。公司控股股

东、实际控制人李明先生，实际控制人董芳梅女士及宁波通慕三者为一致行动人。

希荻微:2024年股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告

公司10月16号发布公告，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性负责。根据《上市公司股权激励管理办法》及《希荻微电子集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司披露2024年股票期权激励计划的行权时间如下：2024年股票期权激励计划首次授予部分进入第一个行权期，行权代码为1000000597，行权时间为2025年5月22日至2026年3月27日；预留授予部分进入第一个行权期，行权代码为1000000709，行权时间为2025年8月6日至2026年7月24日。本次限制行权期为2025年10月26日至10月30日，在此期间全部激励对象将限制行权。公司将按规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理相关事宜。

光峰科技:关于与深圳技术大学签署共建联合实验室合作协议暨关联交易的公告

公司10月16号发布公告，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳光峰科技股份有限公司拟与深圳技术大学签署《光峰科技与深圳技术大学联合实验室合作协议》，共同建立联合实验室，围绕半导体激光等领域开展合作研发，促进上游器件创新及产学研合作。协议有效期6年，公司计划提供不超过人民币600万元经费。该事项构成关联交易，但不属于重大资产重组，无需相关部门批准。本次交易已获独立董事事前认可并通过公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事宇存玺先生已回避表决，无需提交股东大会审议。

国芯科技:第三届董事会第四次会议决议公告

公司10月16号发布公告，于2025年10月16日召开第三届董事会第四次会议。会议以现场和视频结合方式进行，程序符合相关法律法规和公司章程。会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的结果批准授予176名激励对象共922.0686万股限制性股票，授予价格为14.97元/股，授予日为2025年10月16日。关联董事郑莎、肖佐楠、陈石因涉及激励对象身份回避表决。该议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议，相关公告已在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上交所网站披露。

中科飞测:深圳中科飞测科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方、四方监管协议的公告

公司10月16号发布公告，深圳中科飞测科技股份有限公司根据中国证监会于2025年8月4日出具的《关于同意深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，于2024年度向特定对象发行A股28,571,428股，发行价格为87.50元/股，募集资金总额人民币250,000.00万元，扣除发行费用人民币1,923.26万元后，实际募集资金净额为人民币248,076.74万元。上述募集

资金到账情况已由容诚会计师事务所审验，并出具容诚验字。

金安国纪:关于独立董事减持股份实施情况公告

公司10月16号发布公告，于2025年8月4日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于独立董事减持股份预披露公告》。独立董事杨德利先生计划在减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内，即2025年8月25日至2025年11月24日，通过集中竞价方式减持不超过5000股公司股份，占公司总股本比例不超过0.00069%。公司及董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露信息与信息披露义务人提供的资料一致。

鸿利智汇:2025年半年度权益分派实施公告

公司10月16号发布公告，于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《2025年半年度权益分派方案》。本次分红以707,943,506股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，含税，共计派发现金红利70,794,350.60元，不进行送股或转增股本。自权益分派实施至公告日，公司股本总额未发生变化，分红方案与股东大会审议内容一致，实施时间不超过两个月。税收方面，对合格境外机构投资者股息红利统一按10%税率代扣代缴，对香港市场投资者根据税法按10%征税。

则成电子:持股5%以上股东拟减持股份不超过2%的预披露公告

公司10月17日发布公告，深圳市则成电子股份有限公司称持股5%以上股东、系员工持股平台且为实控人一致行动人的深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）拟因资金需求，自公告披露之日起30个交易日后的3个月内通过集中竞价或大宗交易减持不高于2,767,238股、占总股本2%，减持价格随市确定但不低于公司上市发行价；截至公告日其持股13,600,832股、占比9.8299%，本次计划可能在3个月内通过集中竞价减持超过公司总股本的1%，但不涉及控制权变更，不会对生产经营产生不利影响，亦不存在不得减持情形，包括最近20个交易日股价不低于发行价与每股净资产且最近一期经审计净利润为正。公司提示减持存在实施时间、数量与价格不确定性，若采用大宗交易方式，受让方受让后6个月内不得减持。

中石科技:关于泰国孙公司签订《工厂建设项目EPC工程总承包合同》暨对外投资的公告

公司10月17日发布公告，北京中石伟业科技股份有限公司表示，其泰国全资孙公司JonesTech (Thailand) Co., Ltd. 近日与中国建筑工程（泰国）有限公司及世源科技工程有限公司正式签订《工厂建设项目EPC工程总承包合同》，合同金额为97,241.60万泰铢（折合人民币约2.14亿元），用于实施总投资7.37亿元的“中石（泰国）精密制造项目”，该项目位于泰国罗勇府WHA工业园区，计划建设约5万平方米厂房，生产石墨膜、导热材料、屏蔽材料及胶粘剂等产品，服务海外客户。公司称合同为固定总价形式，资金来源为自有及募集资金，不构成关联交易或重大资产重组；项目建成后将丰富产品结构、缓解国内产能压力并提升国际化布局。公司指出该项目有助于增强盈利和抗风险能力，但在泰国实施仍存在政策、法律及文化差异等风险，公司已通过保险与项目组管理措施降低潜在不确定性。

圣邦股份:关于公司控股股东的一致行动人股份减持计划的预披露公告

公司10月17日发布公告,圣邦微电子(北京)股份有限公司称其控股股东一致行动人之一、董事林林计划自公告披露15个交易日后至2026年2月9日期间,通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过7,887,125股,占公司总股本的1.28%,减持股份来源为公司上市前持股及资本公积金转增所得,减持原因为偿还债务。林林目前持股31,548,497股,占比5.10%,减持价格将根据市场行情确定且不低于发行价。公司表示,林林此前已严格履行上市时关于锁定期及减持比例的承诺,本次减持计划符合相关监管规定,不会导致公司控制权变更或影响经营稳定,但存在减持时间、价格及规模不确定性,公司将持续督促其依法合规减持并及时披露进展。

联动科技:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份的预披露公告

公司10月17日发布公告,佛山市联动科技称控股股东、实控人张赤梅及其一致行动人郑俊岭合计持有公司约4,500万股(占剔除回购股后总股本的64.33%),拟自公告披露满15个交易日后的三个月内,即2025年11月10日至2026年2月9日,通过集中竞价或大宗交易合计减持不超过2,096,000股,约占2.9963%,其中两人各自通过集中竞价与大宗交易拟分别减持不超过349,000股与699,000股;减持价格随市确定但不低于发行价,按历次权益分派已调整为每股61.63元;本次减持股份均为首发前取得,相关主体此前承诺已严格履行,计划符合监管规定,不会导致控制权变更,但具体实施时间、数量与价格存在不确定性。

经纬辉开:关于对外投资收购股权的公告

公司10月17日发布公告,拟以现金8.5亿元收购中兴系统技术有限公司100%股权,卖方为深圳银谷科技集团、聚力弘创一号与二号;完成后中兴系统将纳入合并报表、成为全资子公司,交易非关联、不构成重组,尚需股东大会审议。标的评估值为8.528694亿元,协议约定先支付6亿元后办理工商变更;卖方承诺2025—2027年累计净利润不少于2.15亿元,若累计完成度低于90%触发现金补偿,卖方对补偿承担连带责任。标的主营专网通信/工业互联/企业数字化全栈服务,2024年营收105.52亿元、净利0.66亿元;2025年上半年营收5.06亿元、净利0.32亿元;2025年6月末资产18.92亿元、净资产0.72亿元。公司称收购有助于切入专网通信、与现有业务形成协同并提升盈利能力;风险在于交割不确定、业绩兑现与协同不达预期等。

五、下周重要事件提示

表 3: 下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	CNCC2025 (中国计算机大会)	10. 22-10. 25	哈尔滨市	中国计算机学会 (CCF)
2	第 27 届中国电子学会青年年会专	10. 24-10. 26	杭州市	中国电子学会

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前 金元在先

	题论坛			
3	通信感知一体化学术研讨会	10.20	西安市	中国电子学会
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	鸿利智汇	股东大会举办	2025-10-24	
2	汉桑科技	股东大会举办	2025-10-24	
3	腾景科技	股东大会举办	2025-10-24	
4	纬达光电	股东大会举办	2025-10-24	
5	富乐德	股东大会举办	2025-10-23	
6	利扬芯片	股东大会举办	2025-10-23	
7	弘景光电	股东大会举办	2025-10-21	
8	紫光国微	股东大会举办	2025-10-20	
9	冠石科技	股东大会举办	2025-10-20	

数据来源: Choice, 金元证券研究所

表 4: 电子行业限售股解禁情况汇总 (单位: 万股)

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解售股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
688007.SH	光峰科技	2025-10-20	29.12	45,961.56	45,932.44	99.94	45,961.56	100.00	股权激励一般股份
688209.SH	英集芯	2025-10-20	13,036.20	42,933.14	29,896.94	69.64	42,933.14	100.00	追加承诺限售股份上市流通
688061.SH	灿瑞科技	2025-10-20	172.33	11,488.94	4,329.78	37.69	4,502.11	39.19	首发原股东限售股份
688020.SH	方邦股份	2025-10-20	102.00	8,135.20	8,135.20	100.00	8,237.20	101.25	股权激励一般股份
688279.SH	峰昭科技	2025-10-20	3,650.51	11,391.94	5,585.82	49.03	9,236.34	81.08	追加承诺限售股份上市流通
688325.SH	赛微微电	2025-10-22	2,615.71	8,613.90	5,384.29	62.51	8,000.00	92.87	追加承诺限售股份上市流通
301106.SZ	骏成科技	2025-10-22	49.35	10,162.13	10,162.13	100.00	10,211.48	100.49	股权激励一般股份
688127.SH	蓝特光学	2025-10-22	13.60	40,332.84	40,319.24	99.97	40,332.84	100.00	股权激励一般股份
300657.SZ	弘信电子	2025-10-22	267.65	48,255.58	46,861.31	97.11	47,128.95	97.67	股权激励限售股份
301626.SZ	苏州天脉	2025-10-24	2,659.10	11,568.00	2,602.80	22.50	5,261.90	45.49	首发原股东限售股份, 首发战略配售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准:

请务必仔细阅读本报告最后部分的免责声明

曙光在前 金元在先

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。